

2026 年 4 月 28 日

各 位

会 社 名 ニデックアドバンステクノロジー株式会社

代表者名 代表取締役社長 山崎 秀和

所 在 地 京都府向日市ニデックパーク 33 番地 C 棟

SEMICON SEA 2026 への出展について

ニデックアドバンステクノロジー株式会社（以下、当社）は、2026 年 5 月 5 日（火）～5 月 7 日（木）にクアラルンプールの Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) で開催される「SEMICON Southeast Asia 2026」に出展いたします。



外観検査装置「AURCA シリーズ」

今回の展示会では AI 解析機能を搭載した最新の外観検査装置「AURCA シリーズ」をはじめ、パワー半導体向け IGBT/SiC パワーモジュール用検査装置「NATS シリーズ」、当社の主力製品である半導体パッケージ基板用導通・短絡検査システム「GATS シリーズ」など、半導体業界向けに最新のテストソリューションを紹介いたします。

また、当社子会社の Nidec SV Probe からは最新の技術を用いたプローブカードを紹介します。デバイス表面温度を正確に測定する熱電対プローブ、高電圧と高温によるスパークによる損傷を抑制するチャンバーヘッドプローブカードは、次世代 AI や車載市場でより信頼性が高く、効率的なテストソリューションを提供します。

〈出展概要〉

- ・会期：2026 年 5 月 5 日（火）～7 日（木）
- ・会場：Malaysia International Trade & Exhibition Centre (MITEC) in Kuala Lumpur.
- ・ブース：Level 2, Booth# 2396
- ・公式サイト：<https://expo.semi.org/southeastasia2026/public/enter.aspx>

〈主な展示製品〉

- ・大型トレイ対応 2D/3D 半導体ウエハ光学式検査装置 RWi-300MK3 シリーズ
- ・大型基板対応 3D/AFVI+AI 検査装置 AURCA シリーズ
- ・大型トレイ対応 3D Bump 光学式検査装置 RSH シリーズ
- ・ウエハおよび PLP 向け 2D+3D 検査装置 AURCA-S シリーズ
- ・IGBT/SiC パワーモジュール検査装置 NATS シリーズ
- ・アドバンスパッケージ対応導通/短絡検査装置 GATS シリーズ
- ・高精度プローブピン
- ・ウエハ検査用プローブカード